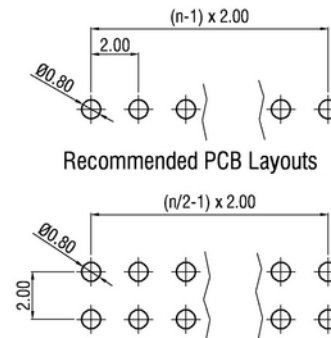
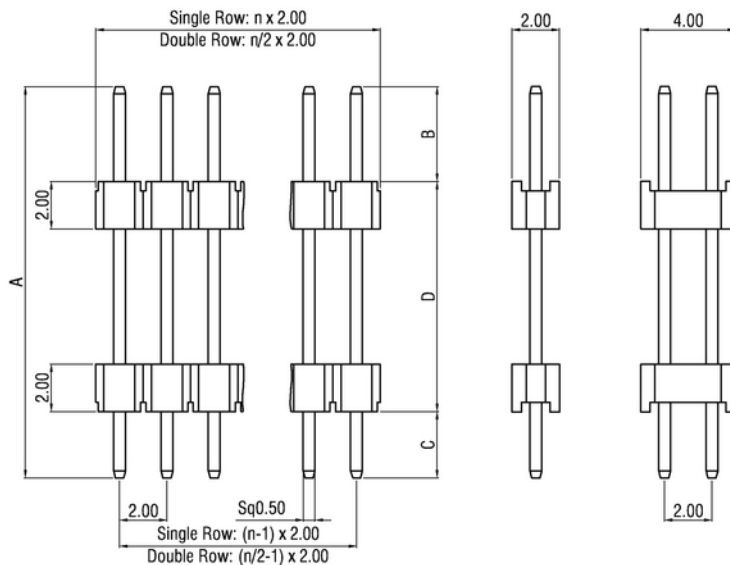
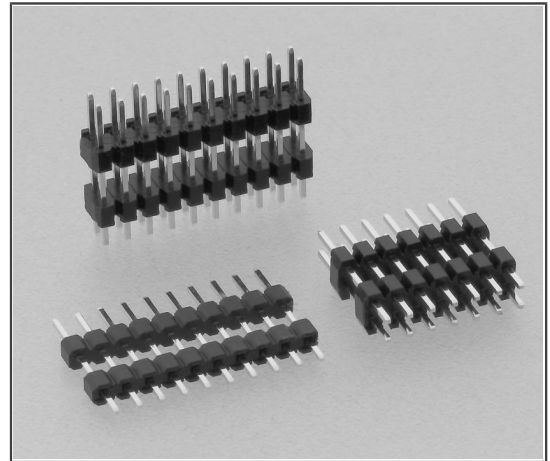


Sandwich-Stiftleisten RM 2,00mm, 1-/2-reihig

Dual Body Pin Headers, 2.00mm Pitch, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>0.50mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
<i>Test Voltage</i>	<i>1 kV DC</i>
Nennspannung	250 V AC
<i>Voltage Rating</i>	<i>250 V AC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave or reflow soldering</i>



Series	Dimensions*	Contacts*	Type*	Plating*
TC-1468	14,3	036	20	60
	14,3 A=14,30 B=4,00 C=2,80 D=7,50mm 16,5 A=16,50 B=4,00 C=2,80 D=9,70mm 18,6 A=18,60 B=4,00 C=2,80 D=11,80mm A [mm] Kundenspezifisch (max. 70,0mm) <i>Customer-specific (max. 70,0mm)</i>	001-040 Einreihig <i>Single row</i> 004-080 Zweireihig <i>Double row</i>	10 Einreihig, gerade <i>Single row, straight</i> 20 Zweireihig, gerade <i>Double row, straight</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 4,00mm, 6,00mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter Techn. Informationen.

We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 4,00mm, 6,00mm, etc. and other pitches by request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

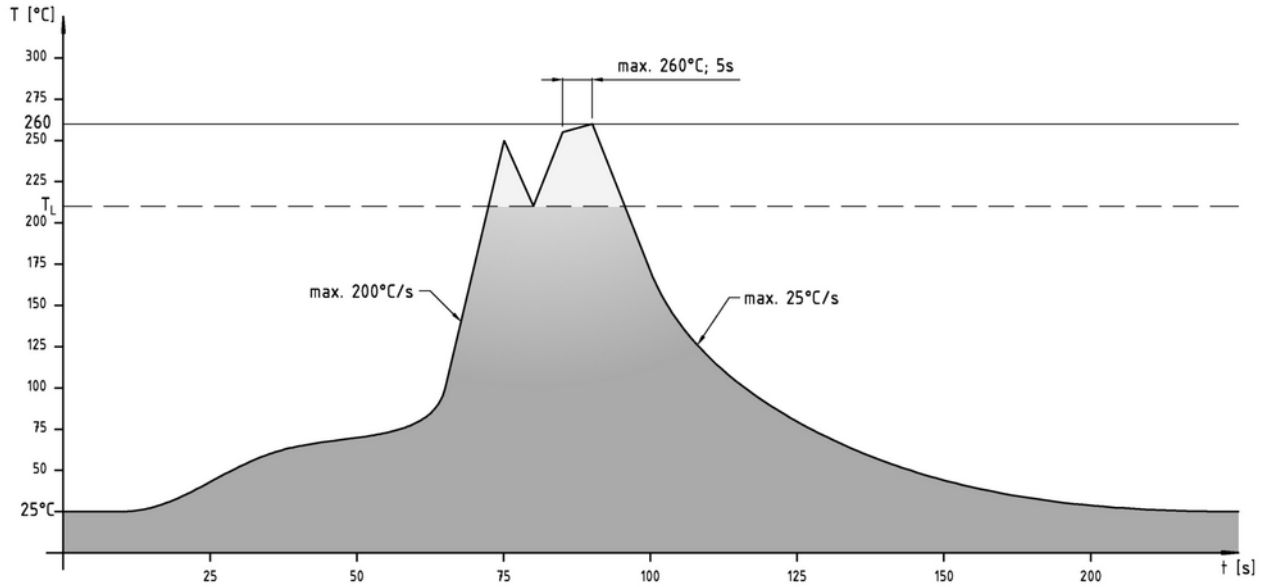
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Löttempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

